

Title (en)
Platin alloy and method for its manufacture

Title (de)
Platinlegierung und Verfahren zu deren Herstellung

Title (fr)
Alliage de platine et son procédé de fabrication

Publication
EP 1820867 A1 20070822 (DE)

Application
EP 07102132 A 20070212

Priority
DE 102006007556 A 20060216

Abstract (en)
A platinum alloy contains (wt.%): 47.5-79.5 platinum; 2.01-25 palladium; and 3-50.49 copper. An independent claim is also included for the production of the platinum alloy.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Platinlegierung, die 47,5 bis 79,5 Gew.-% Platin, 2,01 bis 25 Gew.-% Palladium und 3 bis 50,49 Gew.-% Kupfer enthält. Die Platinlegierungen haben ausgezeichnete mechanische und optische Eigenschaften und sind hervorragend für die Verwendung in der Schmuckfertigung geeignet. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung der Platinlegierungen und deren Verwendung zur Herstellung von Schmuckerzeugnissen. Sie ist darüber hinaus auf Schmuckerzeugnisse, welche die Platinlegierungen umfassen, sowie auf ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet.

IPC 8 full level
C22C 5/04 (2006.01); **A44C 27/00** (2006.01); **C22C 5/00** (2006.01)

CPC (source: EP)
A44C 27/003 (2013.01); **C22C 5/04** (2013.01)

Citation (applicant)
US 6048492 A 20000411 - SHERSHER IGOR [US]

Citation (search report)
• [A] US 2005169791 A1 20050804 - TEWS PETER [DE]
• [DA] US 2279763 A 19420414 - SPENCER SIVIL CECIL
• [A] US 6048492 A 20000411 - SHERSHER IGOR [US]
• [DA] JP S61133340 A 19860620 - TANAKA PRECIOUS METAL IND
• [DA] US 5846352 A 19981208 - KRETCHMER STEVEN [US]

Citation (examination)
• EP 1308527 A1 20030507 - TANAKA PRECIOUS METAL IND [JP]
• WO 2005075690 A1 20050818 - DEGUSSA [DE], et al

Citation (third parties)
Third party :
• EP 1308527 A1 20030507 - TANAKA PRECIOUS METAL IND [JP]
• WO 2005075690 A1 20050818 - DEGUSSA [DE], et al

Cited by
RU2675012C1; CN115896529A

Designated contracting state (EPC)
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)
AL BA HR MK YU

DOCDB simple family (publication)
EP 1820867 A1 20070822; DE 102006007556 A1 20070823; DE 202007018312 U1 20080508; DE 202007018831 U1 20090604

DOCDB simple family (application)
EP 07102132 A 20070212; DE 102006007556 A 20060216; DE 202007018312 U 20070212; DE 202007018831 U 20070212